

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2253号）。《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	上海合晶硅材料股份有限公司	证券简称	上海合晶
证券代码/网下申购代码	688584	网上申购代码	787584

网下申购简称	上海合晶	网上申购简称	合晶申购
所属行业简称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（股）	595,854,316	拟发行数量（股）	66,206,036
预计新股发行数量（股）	66,206,036	预计老股转让数量（股）	0
发行后总股本（股）	662,060,352	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	10.00
网上初始发行数量（股）	10,592,500	网下初始发行数量（股）	42,372,329
网下每笔拟申购数量上限（股）	22,000,000	网下每笔拟申购数量下限（股）	800,000
初始战略配售数量（股）	13,241,207	初始战略配售占拟发行数量比（%）	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数（股）	3,310,302	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（股/万元）	6,620,603 股 /7,208.00 万元
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2024 年 1 月 25 日(T-3 日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2024 年 1 月 29 日 (T-1 日)
网下申购日及起止时间	2024 年 1 月 30 日 (T 日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2024 年 1 月 30 日(T 日) 9:30-11:30 , 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2024 年 2 月 1 日(T+2 日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2024 年 2 月 1 日 (T+2 日) 日终
发行人和保荐人、主承销商及联席主承销商			
发行人	上海合晶硅材料股份有限公司		
联系人	庄子祯	联系电话	021-57843535-5829
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-60833640
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620563

发行人：上海合晶硅材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2024年1月22日

本页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书提示性公告》之盖章页）

上海合晶硅材料股份有限公司
2024年1月22日



本页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）



本页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

